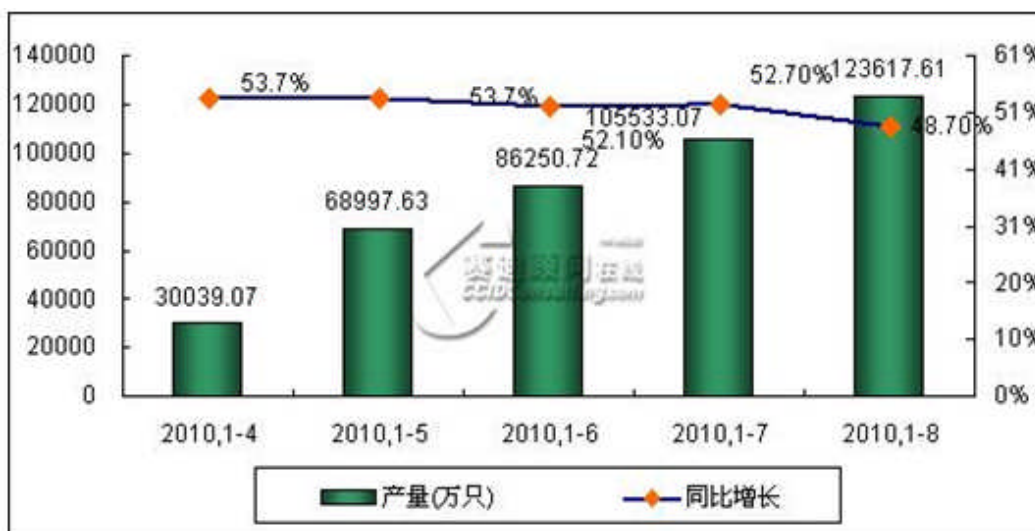


生産データ

2010年8月におけるチップ生産量の月別変化

製品	去年同期	本月合計	去年同期比
チップ(万枚)	83132.2	123617.61	48.7%



2009年第1四半期における半導体業界の主要製品生産データ

製品名	単位	本季度産量		本月止累計産量	
		数量	环比增长	数量	同比增长
電子部品	万	9432894.5		9432894.5	-29.0%
カラーブラウン管	万	563.2		563.2	-63.1%
IC	万	730574.1	-24.8%	730574.1	-18.5%
半導体分立器件	万	4166399.1	-44.3%	4166399.1	-25.8%
薄型パネル	万	128.31	-53.3%	128.31	-74.0%
パネル	万	5.30	-91.0%	5.30	-96.1%
チップ	万	18902.00	-82.5%	18902.00	-58.8%
晶圆片	万	33.50	-43.2%	33.50	-60.6%

販売データ

2009年第3四半期における半導体業界の主要製販売データ

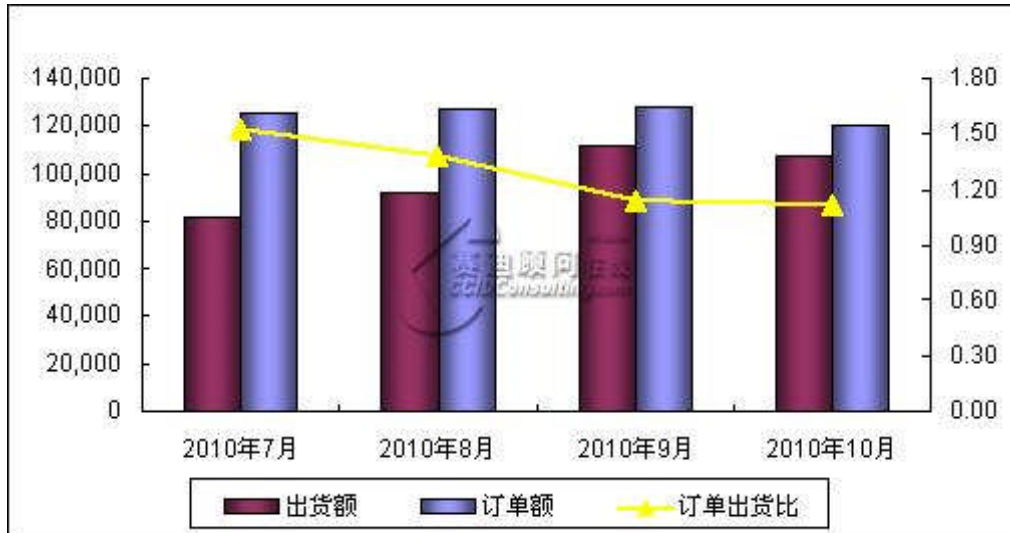
产品	年份	Q32008	Q42008	Q12009	Q22009	Q3 2009
智能卡	销量(万张)	23498.69	24207.14	27776.4	29316.24	28696.53
	增长率(按销量)	-18.11%	3.01%	14.74%	5.54%	-2.11%
	销售额(亿元)	10.84	12.19	14.68	15.83	14.69
	增长率(按销量额)	-26.15%	12.40%	20.43%	7.83%	-7.23%
汽车音响	销量(千台)	2400.7	2353	2532.6	3225.2	3623.5
	增长率	-1.10%	-2.00%	7.60%	27.30%	12.30%
手机芯片	销量(亿块)	28.7	27.6	21.8	27.5	33.6
	增长率(按销量)	1.80%	-3.80%	-21.00%	26.10%	22.30%
	销售额(亿元)	197.5	187	145	182.2	221.4
	增长率(按销量额)	-0.60%	-5.30%	-22.50%	25.70%	21.50%
半导体市场	市场规模(亿元)				1503.99	1665.43
	同比增长				-11.89%	-8.24%
集成电路产业	销售收入(亿元)	332.3	274.2	202.7	256.3	266.8
	环比增长	-0.10%	-17.50%	-26.10%	26.40%	4.10%

5、受注出荷の変化

2010年10月における日本半導体設備市場の受注・出荷状況

単位:100万円

	出荷額	订单額	订单出货比
2010年07月	82,168	125,393	1.53
2010年08月	92,506	127,468	1.38
2010年09月	112,072	127,963	1.14
2010年10月	107,556	120,413	1.12



6、投資のホットスポット観測

天長太陽エネルギー電池プロジェクト(建設中)

项目名称	天长太阳能电池项目
投资方	安徽天长吉阳新能源有限公司
项目金额	50 亿元人民币
项目所在地	安徽
建成后产能	<p>项目建设期限为 3 年，分三期实施建设：一期投资建设 18 条年产能为 750MW 高效晶硅太阳能电池片生产线，拟定 2011 年 8 月建成投产，达产后年可实现产值 80 亿元，税收收入 3 亿元以上；二期投资建设 12 条年产能为 500MW 高效晶硅太阳能电池片生产线，将于 2012 年 6 月建成投产，一二期建成后，年可实现产值 130 亿元，税收收入 5 亿元以上；三期投资建设 18 条年产能为 750MW 高效晶硅太阳能电池片生产线，将于 2013 年 10 月底前投产，全部建成投产后，年可实现产值超 200 亿元、税收收入 8 亿元。同时还将投资 5 亿元以上配套建设部分铸锭切片和组件生产线。</p>